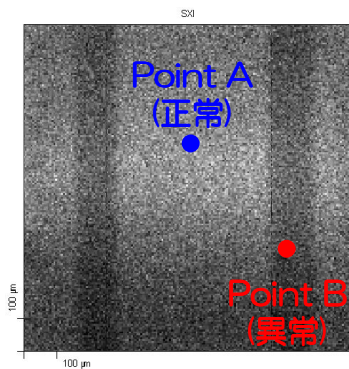


剥離フィルムの剥離不良分析

接着面を保護する剥離フィルムが剥がしにくい原因を探りました。
剥離不良部は、スジ状に観察(Fig.1)。



XPS(ESCA)



X線光電子分光分析装置。
ターゲット表面の深さ10nmの範囲を測定

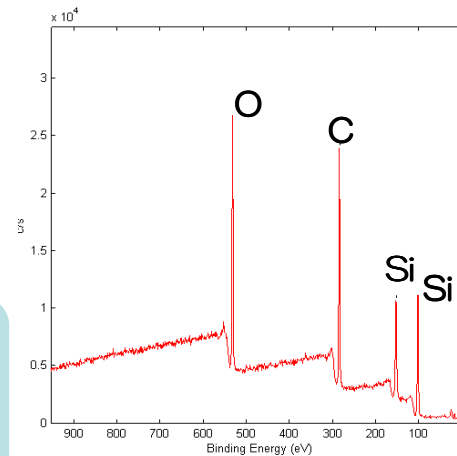


Fig.2 剥離フィルムのスペクトル

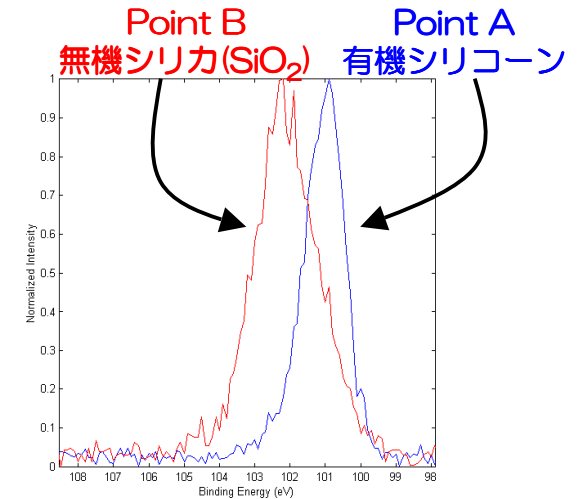


Fig.3 PointAとBのシリコン (Si)のスペクトル

表面のシリコン系剥離剤が酸化し剥離力が落ちていました。
Point A(正常)は剥離剤の有機シリコンが検出されているのに対し、Point B(異常)は無機シリカが検出されています。
酸化により有機シリコンが無機シリカに変質し、剥離不良が生じました。

巴川分析センターは分析力でモノづくりを支援します。まずはお気軽にご相談ください。TEL:054-256-4163
FAX:054-256-4214 URL:<http://bunseki.tomoegawa.co.jp> E-mail:bunseki@tomoegawa.co.jp